

2025 年精益與數位活動發表大會圓滿舉行，共促集團轉型發展

2025 年 06 月 25 日，臻鼎科技集團推動數位轉型戰略，踐行 CA-PDCA 持續改善精神，舉辦 2025 年 H1 精益與數位活動發表大會，提升企業競爭力。簡禎富總經理及各單位高階主管一起推動精益與數位轉型改善的全員參與。

簡禎富總經理在致辭中強調，提案改善大會是臻鼎科技集團創新文化的一環，精益管理與數位轉型也是臻鼎集團永續發展的基石，所有同仁應該主動改善、全員參與和細節著手，發揮「不以善小而不為」的精神，創造日積月累之功。

精益與數位活動發表大會的主辦單位工業工程處、各廠區主管及評審委員，經過層層篩選出 8 份優秀提案進入決賽分享，報告人積極分享經驗成果。評委從各個面向專業點評，激勵各部門擴大效益。榮獲 2025 年精益與數位活動發表大會金獎是軟板事業部 HB06 鐳射課團隊提出的 ESI 鐳射效率提升改善案，透過 OEE 大數據分析、流程梳理精實和創新改善方法應用，優化鐳射精度校正，創造具體改善效益，並導入其他廠區實施。2025 年提案數量較去年同期增長 2.35 倍，成本改善金額翻倍，數位化平臺助力活動更高效透明。

臻鼎科技集團並推動跨單位標杆學習，從各分組中評選出約 90 位最優標杆給予激勵，獲頒沈慶芳董事長親筆「善良 堅忍 利人 感恩」的杯子，期許所有獲獎同仁實踐臻鼎文化。簡總經理肯定所有同仁具體改善成果和決賽精彩報告表現，指示各廠各單位主管應重視且領導持續改善，並要求數轉中心深入分析賦能改善案例，發展系統化解決方案協助改善成果發揮具體效益，擴散到其他單位並深化成果，並建立成功案例知識庫，鼓勵跨單位協助、產學合作等多元創新改善，持續深化集團數位轉型與組織變革。



▲ 簡禎富總經理為大會做開幕致辭

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2024 年連續八年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站：www.zdtco.com。

公司發言人：

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com